

Mitteilung

des Ministeriums für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus

**Unterrichtung des Landtags in EU-Angelegenheiten;
– Vorhaben von erheblicher politischer Bedeutung –¹⁾**

Chip-Verordnung 2.0 COM(2026) 504 final (BR 415/26)

Vorhaben:	Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Rahmen für Maßnahmen zur Stärkung des Halbleiterökosystems und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2023/1781 (Chip-Verordnung 2.0) COM(2026) 504 final
BR-Drucksache:	415/26– ²
Federführendes Ressort:	Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus
Aktenzeichen:	D39873/2026
Beteiligte RessortS:	Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Europa Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

¹⁾ Unterrichtung gemäß Artikel 34a Landesverfassung i. V. m. §§ 2 und 3 des Gesetzes über die Beteiligung des Landtags von Baden-Württemberg in Angelegenheiten der Europäischen Union (EULG) vom 17. Februar 2011 (GBl. 2011, 77).
Vorgelegt mit Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus vom 3. August 2026.

²⁾ Die BR-Drucksache 415/26 kann im Internetangebot des Bundesrats www.bundesrat.de unter der Rubrik „Dokumente“ abgerufen werden.

**Berichtsbogen der Landesregierung gemäß Artikel 34a Landesverfassung i. V. m.
§§ 2 und 3 des Gesetzes über die Beteiligung des Landtags von Baden-Württemberg
in Angelegenheiten der Europäischen Union (EULG)**

1. BR-Drucksachennummer: 415/26
2. Titel der Drucksache: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Rahmen für Maßnahmen zur Stärkung des Halbleiterökosystems und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2023/1781 (Chip-Verordnung 2.0) COM(2026) 504 final
3. Frühwarndokument: ☒ ja ☐ nein Fristbeginn: —
4. Federführendes Ressort: Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus Beteiligte Ressorts: Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Europa Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
5. Datum der voraussichtlichen Behandlung im Bundesrat: 25. September 2026
6. Erhebliche politische Bedeutung für das Land: Ja.

7. a. Gesetzgebungszuständigkeiten des Landes Baden-Württemberg berührt (einschließlich Abweichungsrechte nach Artikel 72 Absatz 3 und Artikel 84 Absatz 1 Satz 2 GG): ☐ ja ☒ nein Alternativ: b. Wesentliche Interessen des Landes unmittelbar berührt: ☒ ja ☐ nein
8. Verweis auf Berichtsbogen der Bundesregierung: Berichtsbogen des BMWF vom 23. Juni 2026
9. Rechtsgrundlage: Dies ist die Überarbeitung des ersten Chip-Gesetzes (Chips Act 1.0; Verordnung (EU) 2023/1781). Der Verordnungsvorschlag, im Weiteren Chips Act 2.0, wird von der Kommission wie beim ersten Chip-Gesetz auf Artikel 173 Absatz 3 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) gestützt.
10. Inhalt: Dies ist ein Vorschlag für eine Verordnung zur Stärkung des Halbleiterökosystems der EU und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2023/1781 (Chips Act 2.0). Er zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit, technologische Souveränität und Resilienz der EU im Halbleitersektor zu erhöhen, die Krisenvorbereitung zu verbessern und die Sicherheit der Versorgung zu gewährleisten. Der Vorschlag umfasst Maßnahmen zur Förderung der Halbleiterdesign- und Fertigungskapazitäten, zur Beschleunigung industriell relevanter Innovationen und ihres Transfers in die wirtschaftliche Praxis, zur Verbesserung der Krisenvorbereitung und Reaktionsmechanismen sowie zur Stärkung der Nachfrage nach Halbleitern in kritischen Sektoren. Er sieht auch die Fortführung des Europäischen Halbleitergremiums (European Semiconductor Board, ESB) sowie die Einrichtung eines Netzwerks für Halbleiterregionen vor, um die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission zu fördern. Der Vorschlag wird von einer Bewertung der aktuellen Verordnung (EU) 2023/1781 begleitet, die deren Erfolge und Herausforderungen hervorhebt und die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen unterstreicht. Inhaltliche Schwerpunkte: Der Verordnungsvorschlag hat weiterhin drei Säulen: • <u>Säule I:</u> Aufbau technologischer Kapazitäten und Innovationen in der Union für die Entwicklung und den Einsatz hochmoderner Halbleiter-, Photonik- und Quantentechnik; das Chips Joint Undertaking (Chips JU) und die bereits bestehenden Pilotlinien sollen fortgesetzt werden. • <u>Säule II:</u> Schaffung eines Rahmens zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit durch Mobilisierung von Investitionen und verbesserten Produktionskapazitäten. • <u>Säule III:</u> Schaffung eines Koordinierungsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission zur Marktüberwachung und Krisenreaktion. Neu im Chips Act 2.0 eingeführt werden insbesondere: • Die Kategorie der „Strategic Projects“ als neues Label mit Privilegien (Artikel 16). Die Kommission schafft damit einen Mechanismus, um industrielle Großprojekte (jenseits des bislang im

Chips JU verfolgten FuE-Fokus) in vorgeschlagenen Bereichen anzuschieben und dabei, je nach Ausgang der Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen (MFR), potentiell auch EU-Mittel zu nutzen. Hier sind noch Fragen zur Governance und Finanzierung aus dem MFR offen.

- Ein eigener Artikel zu „Advanced Semiconductor Manufacturing“ (Artikel 19): Der Artikel schafft innerhalb der Strategic Projects faktisch eine Sonderstellung für eine europäische Advanced-Node-Fertigung (in Annex II definiert als „EU semiconductor plant that combines leading-edge node chip manufacturing with chiplet integration and 2.5D/3D packaging“ mit 20 bis 40 Milliarden Euro Investitionsbedarf). Hier sind noch Fragen der Wirtschaftlichkeit der Umsetzung sowie zu den Modalitäten der Bewerbung und Projektauswahl offen.
- Nachfrageseitige Instrumente; hierzu zählen insbes. „Grand Challenges“ (Artikel 7) als missionsorientierte Innovationsprojekte mit Ziel auf industrial deployment (ähnlich wie DARPA Challenges in den USA) für strategische Technologiefelder (bspw. KI-Chips oder Packaging-Technologien), ein „Demand Forum“ (Artikel 9) zur Koordinierung von Technologie-Roadmaps zwischen Anbietern und potenziellen Abnehmern und Anwendern sowie „Demand Accelerators“ (Artikel 8), die Co-Design-Prozesse und industrielle Partnerschaften zwischen Anbietern und Abnehmern fördern sollen. Ergänzt wird dies durch ein Instrument für „innovationsorientierte öffentliche Beschaffung“ (Artikel 10), sowie Regelungen für allg. öffentliche Beschaffung im Halbleiterbereich (Artikel 30). Hier sind noch Fragen zur Reichweite der Regelungen sowie ggf. resultierenden Vorgaben an öffentliche Auftraggeber offen; allerdings enthält der Entwurf keine allgemeinen verpflichtenden „Buy European“-Ansätze.
- Aufbau einer digitalen Business-to-Business-Plattform zur Echtzeitbeobachtung von Lieferketten und zur Verbesserung der Krisenvorsorge im Halbleitersektor. Die Teilnahme für Unternehmen ist freiwillig; Unternehmen können bei Mitarbeit aggregierte/anonymisierte Daten von der Plattform zur eigenen Risikovorsorge nutzen.
- Weitere Neuerungen:
 - Einführung eines europäischen Labels für „Semiconductor Regions of Excellence“
 - eine stärkere Verankerung von chip-integrierter Photonik als eigenständigem Schwerpunktbereich
 - Erweiterung des sog. „First-Of-A-Kind“ (FOAK)-Begriffs, um Materialien, Equipment, Packaging, Designaktivitäten und sog. „Fabless“-Geschäftsmodelle zu erfassen.
 - Zusammenführung der bisherigen Labels „Open EU Foundry“ und „Integrated Production Facility“ zur „European semiconductor technology initiative“.

11. Erste Einschätzung zur Vereinbarkeit des EU-Vorhabens mit dem Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz:

Die Union hat den Auftrag, zur Erreichung der Wettbewerbsfähigkeit in Artikel 173 AEUV durch die von ihr verfolgten Politiken und Aktivitäten beizutragen. Artikel 173(1) AEUV stellt fest, dass die Ziele darin bestehen, sicherzustellen, dass die für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Union notwendigen Bedingungen gegeben sind. Im Rahmen eines Systems offener und wettbewerbsorientierter Märkte zielt die Kommission im Vorschlag darauf ab:

- (i) die Anpassung der Industrie an strukturelle Veränderungen zu beschleunigen;
- (ii) eine Umgebung zu fördern, die für Initiative und die Entwicklung von Unternehmen in der gesamten Union, insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, günstig ist;
- (iii) eine Umgebung zu fördern, die für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen günstig ist; und
- (iv) eine bessere Ausnutzung des industriellen Potenzials von Innovations-, Forschungs- und technologischen Entwicklungsstrategien zu fördern.

Die Union kann auf Grundlage von Artikel 173 AEUV Gesetzgebungsakte nur unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses beschließen. Das Ziel und die Reichweite von Artikel 114 AEUV sind die Schaffung und Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes durch die Annahme von Maßnahmen zur Angleichung der nationalen Vorschriften, d. h. auch Harmonisierung. Der Vorschlag erscheint geeignet, die festgelegten Zielsetzungen zu erreichen. Im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne wird im Zuge der Verhandlungen insbesondere auf die Angemessenheit von Teilaspekten des Vorschlags zu achten sein, z. B. die Reichweite der Nachfrageinstrumente.
12. Folgen des EU-Vorhabens für das Land:
<i>a) Finanzielle Auswirkungen</i> Nicht bekannt. Insgesamt fehlen noch Zahlengerüste. Die Finanzierung aus dem laufenden MFR soll durch die Programme Horizon Europe und Digital Europe erfolgen. Die Finanzierung neuer Maßnahmen wird noch nicht aufgeschlüsselt. Die weitere Klärung ist Teil der Verhandlungen zum neuen MFR, die nicht präjudiziert werden dürfen. Deutschland trägt zum MFR mit einem Finanzierungsanteil von knapp einem Viertel bei. Bisherige wettbewerbliche Förderaufrufe der Bundesregierung, die auf der Grundlage des Chips Act 1.0 beruhen, führten bei passfähigen Vorhaben von Unternehmen und Forschungseinrichtungen wiederholt zu signifikanten anteiligen Kofinanzierungsforderungen des Bundes an das Land Baden-Württemberg bzw. weitere betroffene Länder zur Sicherstellung der Zuwendungsfinanzierung.
<i>b) Verwaltungsaufwand</i> Nicht bekannt.
<i>c) Umsetzungsbedarf</i> Nicht bekannt. Die Irische Ratspräsidentschaft möchte das Dossier vorantreiben und hat im Juli mehrere RAG-Sitzungen vorgesehen. Ziel ist eine Annahme in 2. Quartal 2027.
<i>d) Kommunalverträglichkeit</i> Nicht bekannt.
<i>e) ggf. weitere wichtige Aspekte</i> Andauernde/wiederholte weltweite Halbleiterknappheiten (derzeit im Bereich der Speicherchips) und Versorgungsengpässe wirken sich auf zahlreiche Sektoren von zentraler gesellschaftlicher und volkswirtschaftlicher Bedeutung aus (Automobilindustrie, Energie, Kommunikation, Gesundheit und strategische Sektoren wie Verteidigung, Sicherheit und Raumfahrt). Zudem hat Europa im weltweiten Vergleich Nachholbedarf bei KI-Chips, Speicherchips und anderen fortschrittlichen Halbleitern. Als zentrale Herausforderungen nennt die Kommission im Impact Assessment neben Investitions- und Skalierungslücken insb. die unzureichende Nachfrage nach europäischen Chips sowie Defizite bei Resilienz und wirtschaftlicher Sicherheit. Daher verlagere sich der Schwerpunkt der abgeleiteten Maßnahmen von einer primär angebotsorientierten Förderung („Lab-to-Fab“) hin

zu einer stärkeren Markt- und Nachfrageorientierung („Lab-to-Market“) inkl. des gezielten Forcierens strategischer Großprojekte und Challenges. Im Chips Act 2.0 vorgesehen sind daher u. a. strategische Projekte, Innovation Procurement und die Stärkung vertrauenswürdiger Lieferketten.

Deutschland ist der größte Halbleiter-Standort Europas. Die Analyse des Impact Assessment ist weitgehend konsistent mit der Mikroelektronik-Strategie der Bundesregierung. Beide leiten die Ziele technologischer Souveränität, resilienter Wertschöpfungsketten und einer Stärkung der europäischen Mikroelektronikindustrie aus der Ist-Situation ab und betonen die Notwendigkeit einer Stärkung der Nachfrage nach europäisch designten und hergestellten Chips.

Offen sind die finanziellen Verpflichtungen, insbesondere durch die „strategic projects“ und Artikel 19 (Advanced Semiconductor Manufacturing) im künftigen MFR. Industriepolitisch wäre eine solche Ansiedlung wichtig in Europa, allerdings müssen die Projekte mittelfristig wirtschaftlich tragfähig sein und keine Dauersubventionen bedingen, auch nicht aus EU-Mitteln. Zudem setzt sich Deutschland für eine horizontale Reduktion des von der Kommission vorgeschlagenen MFR-Volumens ein.

BERICHTSBOGEN

gemäß Anlage zu § 6 Absatz 2 EUZBBG und Ziffer II. 3. der Anlage zu § 9 EUZBLG

Thema:	Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über einen Rahmen für Maßnahmen zur Stärkung des Halbleiter-Ökosystems der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2023/1781 (Chip-Gesetz 2.0)
Sachgebiet:	Europapolitik, Industriepolitik
Ratsdok.-Nummer:	10094/26 + ADD 1 - 6
KOM-Nummer:	KOM(2026) 504 endgültig
Nummer des interinstitutionellen Dossiers:	2026/0139/COD
Nummer der Bundesratsdrucksache:	Nicht bekannt
Nachweis der Zulässigkeit für europäische Regelungen: (Prüfung der Rechtsgrundlage)	Artikel 173 Absatz 3 und Artikel 114 AEUV
Subsidiaritätsprüfung:	Dies ist die Überarbeitung des ersten Chip-Gesetzes (Verordnung (EU) 2023/1781). Der Verordnungsvorschlag, im Weiteren Chips Act 2.0, wird von der Kommission wie beim ersten Chip-Gesetz auf Artikel 173 Abs. 3 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) gestützt. Die Union hat den Auftrag, zur Erreichung der Wettbewerbsfähigkeit in Artikel 173 AEUV durch die von ihr verfolgten Politiken und Aktivitäten beizutragen. Artikel 173(1) AEUV stellt fest, dass die Ziele darin bestehen, sicherzustellen, dass die für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Union notwendigen Bedingungen gegeben sind. Im Rahmen eines Systems offener und wettbewerbsorientierter Märkte zielt die Kommission im Vorschlag darauf ab: (i) die Anpassung der Industrie an strukturelle

- 2 -

	Veränderungen zu beschleunigen; (ii) eine Umgebung zu fördern, die für Initiative und die Entwicklung von Unternehmen in der gesamten Union, insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, günstig ist; (iii) eine Umgebung zu fördern, die für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen günstig ist; und (iv) eine bessere Ausnutzung des industriellen Potenzials von Innovations-, Forschungs- und technologischen Entwicklungsstrategien zu fördern. Die Union kann auf Grundlage von Artikel 173 AEUV Gesetzgebungsakte nur unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses beschließen. Das Ziel und die Reichweite von Artikel 114 AEUV sind die Schaffung und Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes durch die Annahme von Maßnahmen zur Angleichung der nationalen Vorschriften, d.h. auch Harmonisierung. Der Vorschlag für einen Chips Act 2.0 baut auf den Zielen des aktuellen Chip-Gesetzes auf und behält die dreisäulige Struktur. Die geopolitische Wettbewerbssituation in der Mikroelektronik hat sich seit Annahme des ersten Chip-Gesetzes nicht verbessert. Zwar hat sich seit 2023 Europas Stellung im Markt durch die EU- und nationalen Maßnahmen nicht verschlechtert, Europas Fertigungskapazitäten und Technologiekompetenzen sind gewachsen. Allerdings sieht sich die EU einem rasanten Marktwachstum durch die für KI-Datenzentren notwendigen Halbleiter gegenüber, so dass die globalen Marktanteile nicht nennenswert gestiegen sind und Abhängigkeiten weiter bestehen – auch und insbesondere in den stark wachsenden neuen Feldern mit Bezug zu KI. Industriepolitische Maßnahmen sind daher im globalen Umfeld notwendig. Das erste spezifische Ziel des Chips Act 2.0 unter Säule I ist die Schaffung großer Innovationskapazitäten und der angemessenen technologischen Fähigkeiten in der Halbleiterindustrie, um Innovation zu beschleunigen und anzupassen. Darüber hinaus zielt der Verordnungsentwurf in den Säulen II und III darauf ab, die Widerstandsfähigkeit und die Versorgungssicherheit der Union im Bereich der Halbleitertechnologien zu erhöhen, indem sie Investitionen in die fortgeschrittene Halbleiterfertigung unterstützt und koordiniert (Säule II) und eine koordinierte Überwachung der Markt- und Lieferkettenbedingungen und entsprechende Krisenreaktion ermöglicht (Säule III). Die Kommission stützt die Maßnahmen der Säule I auf Artikel 173(3) des AEUV. Im Falle des Artikels 173(3) AEUV sollten die getroffenen Maßnahmen nicht die Harmonisierung der nationalen Gesetze und Vorschriften, sondern die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz der industriellen Basis für Halbleiter in der Union insgesamt zur
--	--

- 3 -

	Folge haben. Der Chips Act 2.0 zielt darauf ab, die Stärke und Resilienz der europäischen Halbleitertechnologie und des industriellen Umfelds zu stärken und das Innovationspotenzial des Halbleiterökosystems in der gesamten EU zu steigern. Dazu gehört die Verringerung der Abhängigkeit von einer kleinen Anzahl nicht-europäischer Unternehmen und Regionen sowie die Erweiterung der Fähigkeiten der EU, fortschrittliche Halbleiter zu entwerfen und herzustellen. Die Initiative Chips for Europe (Säule I), die durch die neue Gesetzgebung weiterhin unterstützt wird, soll dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen, indem sie die Lücke zwischen der Forschungsexzellenz der EU und der effektiven, nachhaltigen industriellen Umsetzung der in der EU entstehenden Innovationen schließt. Die Säulen II und III des Verordnungsvorschlags, die darauf abzielen, die Resilienz und Versorgungssicherheit der Union im Bereich der Halbleitertechnologien zu erhöhen, werden auf Art. 114 AEUV gestützt. Die Kommission begründet die Wahl des Art. 114 AEUV wie beim ersten Chip-Gesetz damit, dass mit den Säulen 2 und 3 ein harmonisierter Rechtsrahmen für die Stärkung der Resilienz und der Versorgungssicherheit der Union angestrebt und damit das Funktionieren des Binnenmarkts gewährleistet werde. Im Ergebnis sind die vorgeschlagenen Maßnahmen für die koordinierte Überwachung und Krisenreaktion und damit einhergehende Befugnisse hinreichend von Art. 114 AEUV gedeckt. Die im Chips Act 2.0 vorgesehenen Verfahrensfristen (12 Monate für Genehmigungen von Halbleiterprojekten) können – verbunden mit einer angemessenen personellen Ausstattung der zuständigen Behörden – dazu beitragen, die europäische Wettbewerbsfähigkeit insbesondere im dynamischen Umfeld der Halbleiterindustrie zu erhalten. Die neu vorgeschlagenen „strategischen Projekte“ zu Fertigungskapazitäten in kleinen Knotengrößen und im sog. Advanced Manufacturing sollen zur Binnenmarktstabilität beitragen, indem die Chip-Versorgungssicherheit verbessert wird. Auch die innovationsunterstützenden Maßnahmen unter Säule I sind weiterhin von Art. 173 AEUV gedeckt. Fraglich ist noch die Reichweite der Nachfrageinstrumente in Säule I, die den bisherigen Pfad der angebotsseitigen Unterstützung verlassen. Hierzu ist eine vertiefte Diskussion im Rat zu erwarten. Schließlich sind auch die Kriseninstrumente unter Säule III von der Binnenmarktkompetenz umfasst: kürzliche Lieferketten-Herausforderungen wie die Vorgänge rund um Nexperia Ende 2026, die fast zu Produktionsausfällen in der Automobilindustrie geführt haben, haben gezeigt, wie verwundbar Europa bzgl. der Halbleiterlieferketten ist und dass ein koordiniertes Vorgehen und im größten Notfall auch Pflichtmaßnahmen wie prioritäre Chip-Aufträge notwendig sind. Der Chips Act 2.0 erweitert diese Krisenbefugnisse nicht gegenüber dem ersten Chip-Gesetz, sondern stellt mit der B2B-Plattform für eine digitale Lieferkettenüberwachung ein freiwilliges Instrument zur Verfügung.
--	--

- 4 -

	Der Vorschlag entspricht dem Subsidiaritätsprinzip (Art. 5 Abs. 3 EUV). Das Subsidiaritätsprinzip ist mangels ausschließlicher EU-Kompetenz anwendbar. Gemäß Artikel 6 b) AEUV verfügt die Union über eine die Mitgliedsstaaten unterstützende bzw. koordinierende Zuständigkeit im Bereich der Industrie sowie eine geteilte Zuständigkeit für den Binnenmarkt nach Art. 4. Abs. 2 a) AEUV. Der vorgeschlagene Verordnungsentwurf dient der Festlegung und Erreichung konkreter gesamteuropäischer Zielsetzungen, die auf mitgliedstaatlicher, regionaler oder lokaler Ebene allein nicht in hinreichendem Maße verwirklicht werden können. Die übergeordneten Zielstellungen der Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit und des europäischen Halbleiter-Ökosystems insgesamt können auf mitgliedstaatlicher Ebene nicht bzw. nicht ausreichend erreicht werden. Dies gilt etwa für die Koordinierung der unionsweiten Stärkung von Design-, Forschungs- und Produktionskapazitäten wie auch für den koordinierten Mechanismus und die damit begriffene Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zur Detektion und Abmilderung von Halbleiter-Engpässen in Europa.
Verhältnismäßigkeitsprüfung:	Der Vorschlag erscheint geeignet, die festgelegten Zielsetzungen zu erreichen. Im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne wird im Zuge der Verhandlungen insbesondere auf die Angemessenheit von Teilaspekten des Vorschlags zu achten sein, z.B. die Reichweite der Nachfrageinstrumente.
Zielsetzung:	Dies ist ein Vorschlag für eine Verordnung zur Stärkung des Halbleiterökosystems der EU und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2023/1781 (Chips Act 2.0). Es zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit, technologische Souveränität und Resilienz der EU im Halbleitersektor zu erhöhen, die Krisenvorbereitung zu verbessern und die Sicherheit der Versorgung zu gewährleisten. Der Vorschlag umfasst Maßnahmen zur Förderung der Halbleiterdesign- und Fertigungskapazitäten, zur Beschleunigung industriell relevanter Innovationen und ihres Transfers in die wirtschaftliche Praxis, zur Verbesserung der Krisenvorbereitung und Reaktionsmechanismen sowie zur Stärkung der Nachfrage nach Halbleitern in kritischen Sektoren. Er sieht auch die Fortführung des Europäischen Halbleitergremiums (European Semiconductor Board, ESB) sowie die Einrichtung eines Netzwerks für Halbleiterregionen vor, um die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission zu fördern. Der Vorschlag wird von einer Bewertung der aktuellen Verordnung (EU) 2023/1781 begleitet, die deren Erfolge und Herausforderungen hervorhebt und die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen unterstreicht.

- 5 -

Inhaltliche Schwerpunkte:	Der Verordnungsvorschlag hat weiterhin drei Säulen: • Säule I: Aufbau technologischer Kapazitäten und Innovationen in der Union für die Entwicklung und den Einsatz hochmoderner Halbleiter-, Photonik- und Quantentechnik; das Chips Joint Undertaking und die bereits bestehenden Pilotlinien sollen fortgesetzt werden. • Säule II: Schaffung eines Rahmens zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit durch Mobilisierung von Investitionen und verbesserten Produktionskapazitäten. • Säule III: Schaffung eines Koordinierungsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission zur Marktüberwachung und Krisenreaktion. Neu im Chips Act 2.0 eingeführt werden insbesondere: • Die Kategorie der „Strategic Projects“ als neues Label mit Privilegien (Art. 16). Die Kommission schafft damit einen Mechanismus, um industrielle Großprojekte (jenseits des bislang im Chips Joint Undertaking verfolgten FuE-Fokus) in vorgeschlagenen Bereichen anzuschließen und dabei, je nach Ausgang der Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen (MFR), potentiell auch EU-Mittel zu nutzen. Hier sind noch Fragen zur Governance und Finanzierung aus dem MFR offen. • Ein eigener Artikel zu „Advanced Semiconductor Manufacturing“ (Art. 19): Der Artikel schafft innerhalb der Strategic Projects faktisch eine Sonderstellung für eine europäische Advanced-Node-Fertigung (in Annex II definiert als „EU semiconductor plant that combines leading-edge node chip manufacturing with chiplet integration and 2.5D/3D packaging“ mit 20-40 Mrd. Euro Investitionsbedarf). Hier sind noch Fragen der Wirtschaftlichkeit der Umsetzung sowie zu den Modalitäten der Bewerbung und Projektauswahl offen. • Nachfrageseitige Instrumente; hierzu zählen insbes. „Grand Challenges“ (Art. 7) als missionsorientierte Innovationsprojekte mit Ziel auf industrial deployment (ähnlich wie DARPA Challenges in den USA) für strategische Technologiefelder (bspw. KI-Chips oder Packaging-Technologien), ein „Demand Forum“ (Art. 9) zur Koordination von Technologie-Roadmaps zwischen Anbietern und potentiellen Abnehmern und Anwendern sowie „Demand Accelerators“ (Art. 8), die Co-Design-Prozesse und industrielle Partnerschaften zwischen Anbietern und Abnehmern fördern sollen. Ergänzt wird dies durch ein Instrument für „innovationsorientierte öffentliche Beschaffung“ (Art. 10), sowie Regelungen für allg. öffentliche Beschaffung im Halbleiterbereich (Art. 30). Hier sind noch Fragen zur Reichweite der Regelungen sowie ggf. resultierenden Vorgaben an öffentliche Auftraggeber
----------------------------------	---

- 6 -

	offen; allerdings enthält der Entwurf keine allg. verpflichtenden „Buy European“-Ansätze. • Aufbau einer digitalen Business-to-Business-Plattform zur Echtzeitbeobachtung von Lieferketten und zur Verbesserung der Krisenvorsorge im Halbleitersektor. Die Teilnahme für Unternehmen ist freiwillig; Unternehmen können bei Mitarbeit aggregierte/anonymisierte Daten von der Plattform zur eigenen Risikovorsorge nutzen. • Weitere Neuerungen: - o Einführung eines europäischen Labels für „Semiconductor Regions of Excellence“ - o eine stärkere Verankerung von chip-integrierter Photonik als eigenständigem Schwerpunktbereich - o Erweiterung des FOAK-Begriffs, um Materialien, Equipment, Packaging, Designaktivitäten und Fabless-Geschäftsmodelle zu erfassen. - o Zusammenführung der bisherigen Labels „Open EU Foundry“ und „Integrated Production Facility“ zur „European semiconductor technology initiative“.
Politische Bedeutung:	Hoch. Andauernde / wiederholte weltweite Halbleiterknappheiten (derzeit im Bereich der Speicherchips) und Versorgungsengpässe wirken sich auf zahlreiche Sektoren von zentraler gesellschaftlicher und volkswirtschaftlicher Bedeutung aus (Automobilindustrie, Energie, Kommunikation und Gesundheit, und strategische Sektoren wie Verteidigung, Sicherheit und Raumfahrt). Zudem hat Europa Nachholbedarf bei KI-Chips, Speicherchips und anderen fortschrittlichen Halbleitern.
Was ist das besondere deutsche Interesse?	Als zentrale Herausforderungen nennt die Kommission im Impact Assessment neben Investitions- und Skalierungslücken insb. die unzureichende Nachfrage nach europäischen Chips sowie Defizite bei Resilienz und wirtschaftlicher Sicherheit. Daher verlagere sich der Schwerpunkt der abgeleiteten Maßnahmen von einer primär angebotsorientierten Förderung („Lab-to-Fab“) hin zu einer stärkeren Markt- und Nachfrageorientierung („Lab-to-Market“) inkl. des gezielten Forcierens strategischer Großprojekte und Challenges. Im Chips Act 2.0 vorgesehen sind daher u.a. strategische Projekte, Innovation Procurement und die Stärkung vertrauenswürdiger Lieferketten. Deutschland ist der größte Halbleiter-Standort Europas. Die Analyse des Impact Assessment ist weitgehend konsistent mit der Mikroelektronik-Strategie der Bundesregierung. Beide leiten die Ziele technologischer Souveränität, resilienter Wertschöpfungsketten und einer Stärkung der europäischen Mikroelektronikindustrie aus der Ist-Situation ab

- 7 -

	und betonen die Notwendigkeit einer Stärkung der Nachfrage nach europäisch designten und hergestellten Chips. Offen sind die finanziellen Verpflichtungen, insbesondere durch die „strategic projects“ und Art. 19 (Advanced Semiconductor Manufacturing) im künftigen MFR. Industriepolitisch wäre eine solche Ansiedlung wichtig in Europa, allerdings müssen die Projekte mittelfristig wirtschaftlich tragfähig sein und keine Dauersubventionen bedingen, auch nicht aus EU-Mitteln. Zudem setzt sich Deutschland für eine horizontale Reduktion des von der Kommission vorgeschlagenen MFR-Volumens ein.
bisherige Position des Deutschen Bundestages:	Bisher keine Befassung im Bundestag.
Position des Bundesrates:	Bisher keine Befassung im Bundesrat.
Position des Europäischen Parlaments:	Bisher keine Befassung im EP / Nicht bekannt.
Meinungsstand im Rat:	Die Verhandlungen in den Ratsarbeitsgruppen laufen jetzt an. Im Juli stehen vsl. fünf Befassungen der RAG Industrie an (1.7., 8.7., 14.7., 17.7., 24.7.).
Verfahrensstand: (Stand der Befassung)	03.06.2026: Vorstellung durch KOM im Rahmen der Tech Sovereignty Package 22.06.2026 erste Vorstellung in RAG Industrie
Finanzielle Auswirkungen:	Insgesamt fehlen noch Zahlengerüste. Die Finanzierung aus dem laufenden MFR soll durch die Programme Horizon Europe und Digital Europe erfolgen. Die Finanzierung neuer Maßnahmen wird noch nicht aufgeschlüsselt. Die weitere Klärung ist Teil der Verhandlungen zum neuen MFR, die nicht präjudiziert werden dürfen. Deutschland trägt zum MFR mit einem Finanzierungsanteil von knapp einem Viertel bei.

Zeitplan für die Behandlung im

a) Bundesrat:	Nicht bekannt
b) Europäischen Parlament:	Nicht bekannt
c) Rat:	Die Irische Ratspräsidentschaft möchte das Dossier vorantreiben und hat im Juli mehrere RAG-Sitzungen vorgesehen (1.7., 8.7., 14.7., 17.7., 24.7.). Ziel ist eine Annahme in 2. Quartal 2027.